

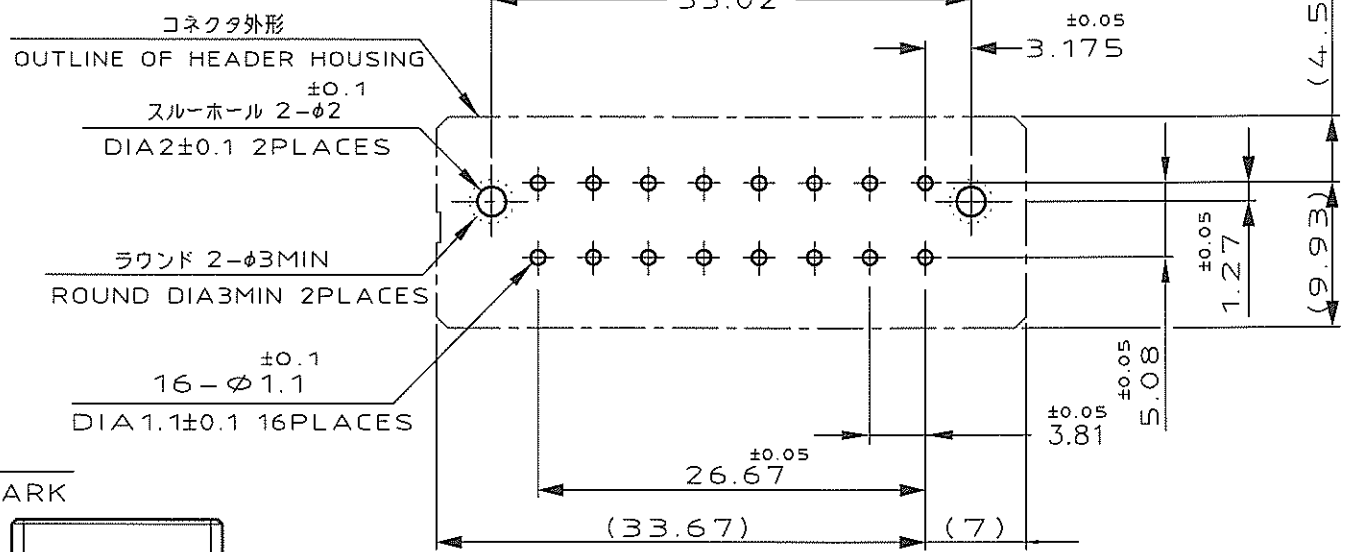
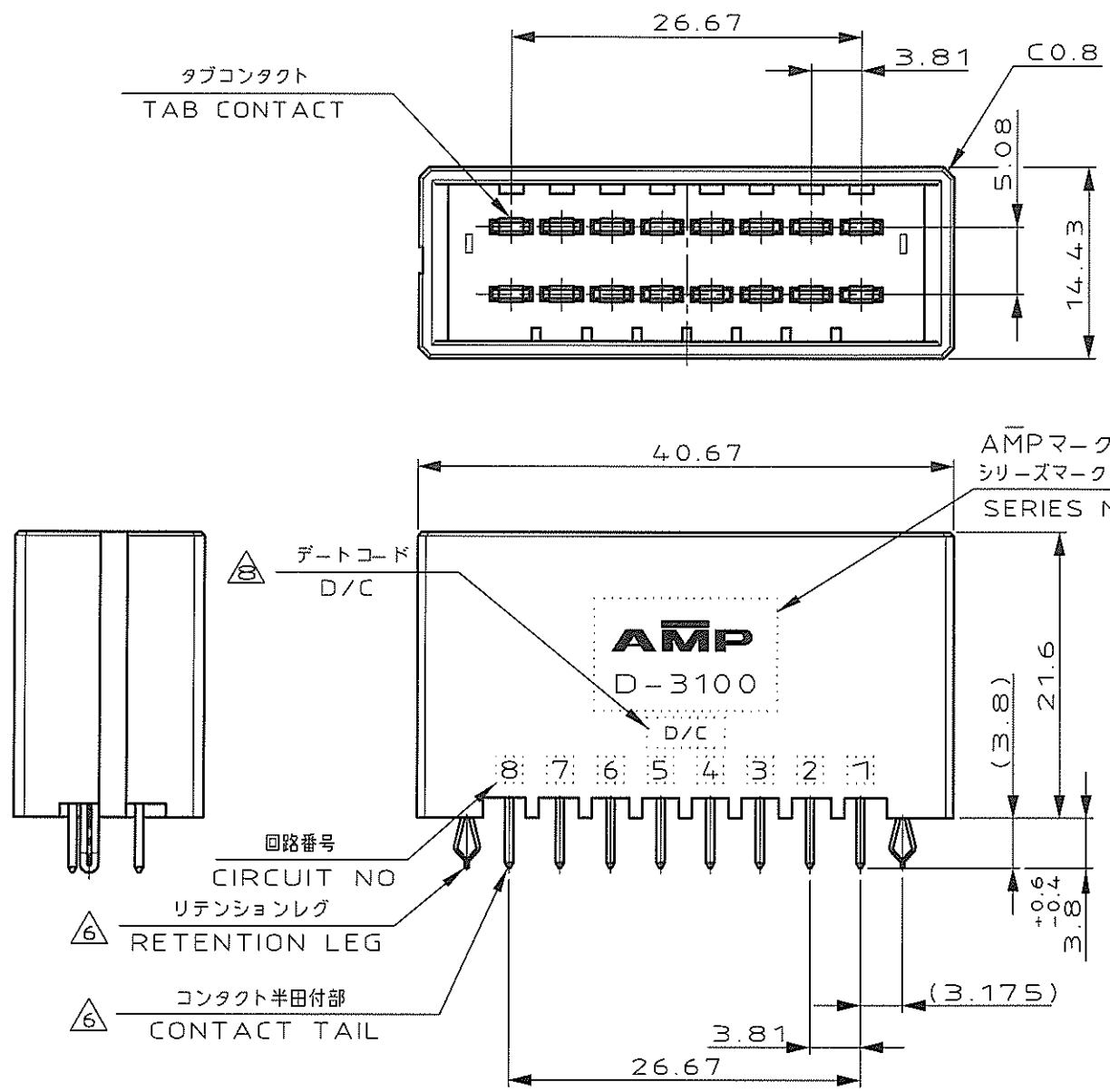
NUMBER 178327



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- THE SHAPE, SIZE AND POSITION OF THE CHARACTER SHOW THE OUTLINE THEY DON'T SHOW DETAILS
- THE DATE CODE SHOW PRODUCTION LOT BY NUMBER. THE NUMBER MAKE UP THE NUMBER OF FOUR COLUMNS OR FIVE COLUMNS. (INCLUDE THE ALPHABET)

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の土に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の土にスズめっき
- 文字の形状、大きさ、および位置については、大略を示すものであり、詳細を示すものではありません
- 4桁の数字及びアルファベットを含む5桁の数字により製造ロットを示す。

△6	△4	178327-5
△6	△3	178327-3
△6	△2	178327-2
(FINISH)	製品番号 (PART NO.)	

E2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	20MAR 11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
mm(AWG)		mm		16 POS DOUBLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC NUMBER
DR. 19 APR 94 N. Matsubara		DE. 19 APR 94 N. Matsubara		100% 30UF : ±0.3	A3 J C-178327
CHK. 20 APR 94 S. MANABE		APP. 20 APR 94 S. MANABE		100% 100UF : ±0.4	SCALE REV. SHEET
				30% 100UF : ±0.45	2-1 E2 1 OF 1
				角度 : ±3'	